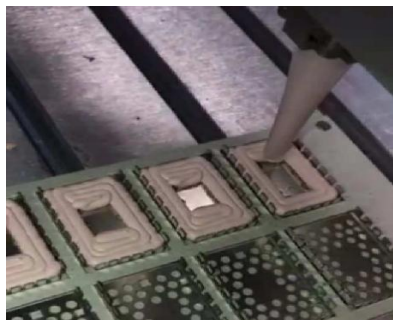




TIF®090-11 是一款柔软的硅胶型间隙填充垫，内含导热填料并采用独特配方，兼具优异的导热性能与极佳的柔软性。与一般导热矽油相比，TIF®090-11 具备更高的黏度，有效防止填料与矽胶基材分离，同时在施加压力时具备更稳定的黏着线控制，提升产品可靠度。TIF®090-11 的使用方式类似于传统导热膏，并可配合多种商用设备施作，例如点胶或自动化生产设备等。其适用于多种高功率电子元件与封装形式，包括：倒装芯片微处理器 (Flip-Chip MPU)、PPGA、微型BGA、BGA、DSP晶片、圆形加速器晶片、LED照明模组等。

特性

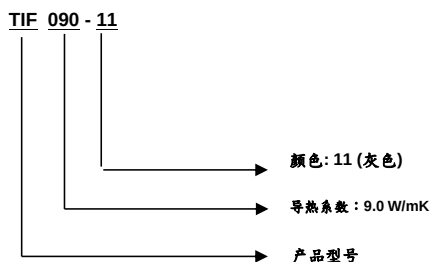
- 》良好的热传导率: **9.0 W/mK**
- 》柔软与器件之间几乎无压力
- 》低热阻抗
- 》可轻松用于点胶系统自动化操作
- 》长期可靠性

应用

- 》散热器底部或框架
- 》LED液晶显示屏背光管，LED电视，LED灯具
- 》高速硬盘驱动器
- 》微型热管散热器
- 》汽车发动机控制装置
- 》通讯硬件
- 》半导体自动试验设备

TIF® 090-11 系列特性表		
产品特性	典型值	测试标准
颜色	灰色	目视
结构&成份	陶瓷填充硅材料	-
粘度 (mPa·s)	13,000,000	GB/T 10247
密度 (g/cc)	3.45	ASTM D297
导热系数 (W/mK)	9.0	ASTM D5470
热阻抗 @10psi (°C·in²/W)	0.089	ASTM D5470
热阻抗 @50psi (°C·in²/W)	0.055	ASTM D5470
建议使用温度范围 (°C)	-45 ~200	-
耐电压强度 (V/mm)	≥4000	ASTM D149
最小界面厚度 (mm)	0.40	-
ΣD3-D10 (硅氧烷含量PPM)	<100	GC-MS
防火等级	V-0	UL94

产品型号说明:



产品规格:

- 30 cc/支, 98支/箱; 300 cc/支 6支/箱
- 或在注射器用于自动化应用定制包装。如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网: <http://www.ziitek.com>



导热灌封胶 | 相变化材料 | 导热矽胶布 | 导热膏 | 导热双面胶 | 导热硅胶片 | 屏蔽材料 | 石墨片 | 导热塑料

加拿大 Canada
TEL: +001-604-2998559
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://www.thermazig.com>

台湾 Taiwan
TEL: +886-2-22771007
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://www.ziitek.com.tw>

东莞 Dongguan
TEL: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://www.ziitek.com>

昆山 Kunshan
TEL: +86-512-57816297
E-mail: kelvin@ziitek.com
<http://www.ziitek.com>

长沙 Changsha
TEL: +86-731-86949836
E-mail: jor@ziitek.com
<http://www.ziitek.com>